令和８年 10 月 30 日

関係各位

（一社）日本実装技術振興協会
会　長　　嶋田　勇三

第 241 定例講演会のお知らせ

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、日本実装技術振興協会の第 241 回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。
　今回は会場と WEB 会議システム（Zoom ウェビナー）を利用してのハイブリッド開催となります。
　ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

１．**開催日時**：令和８年 11 月 19 日（木）定例講演会 13：00～16：30
　　技術交流会 17：00～18：00

２．**開催方式**：ハイブリッド方式
　【川崎市産業振興会館第４会議室＋WEB 会議システム「Zoom ウェビナー」】
　（Zoom 参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）
　川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 20
　https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/

３．**プログラム**：**“トレンドにおける実装技術の今を探る”**

⑴13:00～14:00 **プログラムテーマ①**	『AI 時代の LSI、基板、システムの水冷化技術』 KEI Systems 代表 前田 真一 氏 **講演内容**：AI データーセンターは世界中で急激に増大している。また、AT でえーターセンターの消費電力はこれまでのデーターセンターより桁違いに大きい。この大きな消費電力はほぼ全てが熱に変換される。大電力消費、大量熱発生の AI データーセンターではこれまでの技術の延長でない新しい放熱手法が必要となる。チップレベル、パッケージレベル、ラックレベル、センターレベル各々での新しい冷却技術動向を紹介する。
⑵14:00～15:00 **プログラムテーマ②**	『「熱」の話。～リフロー炉メーカから見た熱プロセスの考え方～』 アントム（株）熱プロセスソリューション本部長 栗田 享 氏 **講演内容**：半導体製造～電子部品製造～SMT 実装と様々な工程で使用されるリフロー炉。接合品質を左右する重要な要素である「熱」。本講演では、リフロー炉メーカーの視点から、接合不良を材料だけの問題として捉えるのではなく、材料・構造・接合面に加え、温度、時間、雰囲気などの熱プロセス全体から考えることの重要性を解説する。また、ピーク温度だけでは見えない温度履歴や、ボイド低減に向けた温度プロファイルの見直し事例を紹介し、実際のワークで評価・検証することの大切さをお伝えする。さらに、リフロー炉に求められる能力や、装置単体の性能にとどまらず、熱プロセス全体を設計・最適化するという考え方を通じて、これからの実装技術における熱プロセスの可能性を考える。
15:00～15:15	― 休　憩 ―
⑶15:15～15:30 **会社紹介**	『調整中』
⑷15:30～16:30 **プログラムテーマ③**	『生成 AI，Agentic-AI から Physical-AI へ，半導体パッケージのこれから』 NEP Tech. S&S，ニシダエレクトロニクス実装技術支援 代表 西田 秀行 氏 **講演内容**：近年、AI／高度情報処理技術が社会インフラ化する中、システム集積を志向した「Advanced Packaging」の重要性が高まっている。話題を集めている技術として、代表格の CoWoS(Chip on Wafer on Substrate；Silicon-Interposer を用いた Heterogeneous-Integration)をはじめ、ガラス基板を用いた Glass Core Interposer、大面積化と低コスト化を実現する PLP（Panel Level Packaging）、局所シリコン配線層を活用する EMIB（Embedded Multi-Die Interconnect）や CoWoS-L（Local Silicon Interconnect）などが注目されている。更に、最近、モバイル向けや車載対応の Solution の提案として、WMCM（Wafer-Level Multi-Chip Module）が話題に上がっている。これらの現状と課題について議論したい。
17:00～18:00	― 技 術 交 流 会 ― 産業振興会館２階「カフェサウダージ」にて

４．参加費

会　員：無料　企業正会員は１社３名まで（Web 会議特例：３名を超える参加者については事務局に問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1 登録 1 名様のご利用でお申込みください。

会員外：22000 円／人（不課税）（お申し込み後，請求書をお送りします）

５．参加申し込み

会　員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mail にてお申し込みいただけますようお願いします。

※今回、会場と Zoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム（https://www.j-jisso.org/p/contact.html）より「お問い合わせ内容」の項目に「第 241 回定例講演会参加希望」と参加方式（会場もしくは Zoom）をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。お申し込み後、折り返しご連絡をいたします。

申込締切日：令和 8 年 11 月 10 日（火）

※講演 2 日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようにお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、当会ホームページの会員のページ（https://www.j-jisso.org/member/）に講演日までにアップいたします。ID と PW が必要ですので講演日前までにご確認ください（企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい）。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局
URL：http://www.j-jisso.org（HP 右上の「お問い合わせ」からご連絡下さい）